

SIC 籽晶热压键合机

2023年4月20日

JMD-WB 的基本功能介绍:

本公司 2008 年就研制出 sic 籽晶粘接设备，到现在是第三代产品；已经提供给国内多家 sic 长晶单位，比如山东大学晶体材料国家重点实验室，中电科 2 所，上海硅酸盐研究所，中电科 46 所，中电化合物（宁波），浪潮华光等。

此设备需要配合专用的粘接工艺才能发挥作用；一般用户有自己的粘接工艺；

此设备主要包含几大部分:

- 真空不锈钢腔体
- 水冷系统
- 上下加热加压装置
- 压盘压力均匀性测试（选件）
- 电气控制和温度控制系统
- 真空测量
- 氩气充气排气，吹气快冷系统
- JMD-V2.0 控制软件：手动和自动程序运行；

设备基本参数:

1. 不锈钢腔体内径 560mm；
2. 适合 4-6 寸籽晶键合；
3. 上下压盘压力最大 1.5T，可连续加压（最大压力可按用户要求定制）
4. 上下压盘最高温度 450 度，上下压盘加热区域：250x250mm
带有超温超压保护，上下独立 PID 精确控温，精度 0.2 度，升温速率小于 40 度 /min，降温速率大于 15 度/min
5. 主机尺寸：L*D*H=1500x900x1980mm（按实际尺寸为准）
6. 真空获得和真空测量，机械泵抽空，真空度最小 10pa

7. 数据记录和自动运行程序

8. 破片率低于 3%

用户配套要求:

1 工厂车间需要冷却水, 压力大于 0.2Mpa

2 万级净化车间

3 气源压缩空气大于 0.6MPa

4 电力: 380vAC /50hz 功率满足: 6kw

5 氩气

6 专用籽晶压接冶具;

